

C2963C

Comunicato stampa Communiqué de presse Comunicato stampa

新闻稿 / 新聞稿 プレスリリース **보도자료**

STMicroelectronics, acquisizioni per rafforzare le capacità di connettività wireless dei microcontrollori STM32

Con queste acquisizioni ST amplia l'offerta di soluzioni di connettività con tecnologia cellulare a banda stretta e tecnologia a banda ultra larga

Ginevra, 16 luglio 2020 – STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha annunciato oggi la firma di due accordi di M&A, uno riguardante l'acquisizione dell'intero capitale azionario di BeSpoon, specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga, e l'altro relativo all'acquisizione delle attività di Riot Micro nella connettività cellulare per IoT. Dopo la chiusura delle due transazioni, soggette alle approvazioni di prassi da parte dei regolatori, ST rafforzerà ulteriormente la sua offerta per la connettività wireless e, in particolare, la roadmap per i microcontrollori STM32 e i microcontrollori "secure".

BeSpoon, che ha sede a Le Bourget du Lac (Francia), è una società *fabless* di semiconduttori fondata nel 2010 e specializzata nella tecnologia di comunicazione a banda ultra larga (Ultra Wide Band - UWB). La sua tecnologia consente una localizzazione in interni affidabile in tempo reale, accurata nell'ordine dei centimetri, in ambienti con condizioni sfavorevoli. L'integrazione di questa tecnologia di posizionamento nel portafoglio dei prodotti STM32 permetterà agli sviluppatori di applicazioni per IoT, automotive e comunicazioni mobili di fornire, ad esempio, servizi di accesso sicurizzato e servizi di mappatura precisi in ambienti interni ed esterni. ST acquisirà BeSpoon dal suo azionista di maggioranza, TRUMPF, e dai suoi fondatori. Parallelamente alla transazione, ST e TRUMPF costituiranno una partnership strategica per la tecnologia di tracciamento UWB.

Riot Micro, che ha sede a Vancouver (Canada), progetta soluzioni cellulari per IoT applicando tecniche di progettazione collaudate, che vanno dal Bluetooth Low Energy (BLE) e dal Wi-Fi fino alle tecnologie LTE Cat-M e NB-IoT, per ottimizzare costi di sistema e consumi di energia. L'integrazione di capacità di comunicazione cellulare nel portafoglio STM32 rafforzerà l'offerta di ST per i clienti che sviluppano applicazioni per tracciamento degli asset, contatori elettronici, e servizi di gestione flotte.

I termini delle transazioni non sono stati resi noti.

"In ST, lavoriamo per offrire ai nostri clienti i prodotti e le soluzioni di cui hanno bisogno per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano. La tecnologia cellulare IoT e la tecnologia UWB sono soluzioni di connettività wireless fondamentali per una nuova ondata di applicazioni innovative e di oggetti connessi a IoT," ha dichiarato Claude Dardanne, Presidente del gruppo Microcontrollori e circuiti integrali digitali di STMicroelectronics. "Queste acquisizioni vanno a integrare l'attuale offerta di microcontrollori wireless di ST, che comprende i protocolli di comunicazione Bluetooth 5.0 e IEEE 802.15.4 insieme al primo System-on-Chip al mondo con tecnologia LoRa®. I microcontrollori wireless fanno parte della nostra offerta di prodotti STM32, che include oltre 1000 dispositivi differenti con oltre sei miliardi di parti spedite ai clienti. Con queste acquisizioni, ci dedicheremo a tutti i protocolli di comunicazione wireless per IoT."

Nota di avvertimento a proposito di dichiarazioni su aspettative future

Dichiarazioni su aspettative future ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995:

Le dichiarazioni di cui sopra che non sono fatti accaduti, comprese le dichiarazioni riguardanti i risultati futuri di nostre attività operative e posizioni finanziarie, strategie di business, piani e obiettivi per operazioni future, sono dichiarazioni su aspettative future e comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in maniera sostanziale da quelli previsti in tali dichiarazioni. Queste dichiarazioni rappresentano soltanto previsioni, riflettono le nostre attuali convinzioni e aspettative rispetto a eventi futuri e sono basate su ipotesi, esposte a rischi e incertezze e soggette a variazioni in qualunque momento. I potenziali rischi e incertezze comprendono, tra gli altri, fattori quali: la possibilità che la transazione non venga perfezionata, inclusa la possibilità che ciò si verifichi per effetto di una o più delle condizioni precedenti; il rischio che i benefici previsti dall'acquisizione non possano essere realizzati; difficoltà a trattenere i dipendenti in seguito all'acquisizione; difficoltà ad espandere gli impianti e a trasferire proprietà intellettuali e *know-how*; la distrazione dell'attenzione del nostro management dalla gestione della nostra attività; e l'impatto della concorrenza e di altri fattori di rischio riguardanti il nostro settore e le nostre attività come dettagliati di volta in volta nei documenti depositati presso la *Securities and Exchange Commission* statunitense.

Alcune informazioni su STMicroelectronics

In ST, siamo 46 mila creatori e costruttori di tecnologie a semiconduttore e governiamo la catena di fornitura nei semiconduttori con siti manifatturieri allo stato dell'arte. Come produttore indipendente di dispositivi lavoriamo con i nostri 100 mila clienti e migliaia di partner per progettare e costruire prodotti, soluzioni ed ecosistemi che rispondono alle loro sfide e opportunità, e alla necessità di supportare un mondo più sostenibile. Le nostre tecnologie consentono una mobilità più intelligente, una gestione più efficiente della potenza e dell'energia e il dispiegamento su larga scala dell'Internet of Things e della tecnologia 5G. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.st.com.

Per ulteriori informazioni, contattare:

RELAZIONI CON GLI INVESTITORI:

Céline Berthier

Group VP, Investor Relations Tel: +41 22 929 58 12

celine.berthier@st.com

RELAZIONI CON LA STAMPA:

Laura Sipala

Direttore relazioni pubbliche e con i media, Italia

Tel: +39.039.6035113

STMicroelectronics.ufficiostampa@st.com